



Advanced Semiconductor Packaging & Chiplet Show 2026

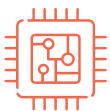
차세대 반도체 패키징 산업전

2026. 8. **26(수)** - **28(금)**
수원컨벤션센터

전시회 개요

- 국 문 2026 차세대 반도체 패키징 산업전
- 영 문 Advanced Semiconductor Packaging & Chiplet Show 2026
- 약 칭 ASPS 2026
- 기 간 2026. 8. 26(수) - 28(금), 3일간
- 장 소 수원컨벤션센터
- 규 모 180개사 500부스 관람객 10,000여명
- 주 최 경기도, 수원시
- 주 관 (주)제이엑스포, (재)수원컨벤션센터, (주)전자신문사
- 후 원 소부장기술융합포럼, 차세대융합기술연구원,
한국기계전기전자시험연구원, 한국나노기술원,
한국마이크로전자및패키징학회,
한국반도체산업협회, 한국실장산업협회,
한국전자기술연구원, 한양대학교링크3.0사업단,
한양첨단패키징연구센터

동시개최 행사



SPTF 반도체 패키징 트렌드 포럼



I.S.E.S. Korea 국제 반도체 경영진 서밋



KPIA 한국실장산업협회 세미나



SBJ 소부장기술융합포럼/연구조합 심포지움



ASPS 참가업체 기술세미나 외





전시 품목



반도체 패키징 테스트 및 공정 장비



반도체 패키징 소재, 부품 및 열 관리 솔루션



반도체 패키징 기술 솔루션
및 설계소프트웨어(EDA)



반도체 글라스 기판 및 가공 소재, 장비



첨단 패키징을 위한 시스템 반도체
(팹리스) 설계 및 IP 활용 솔루션



기타 웨이퍼 가공 소재, 부품, 장비 외

핵심 타겟 바이어

반도체 제조 (IDM & Foundry)

국내외 종합 반도체사, 파운드리 기업



반도체 설계 (Fabless)

팹리스 및 디자인 하우스



패키징 & 테스트 (OSAT & Test)

국내외 OSAT, 테스트 전문 기업



응용 및 수요 기업 (End-users)

AI&ICT/컴퓨팅/자동차/전자 관련 제조사

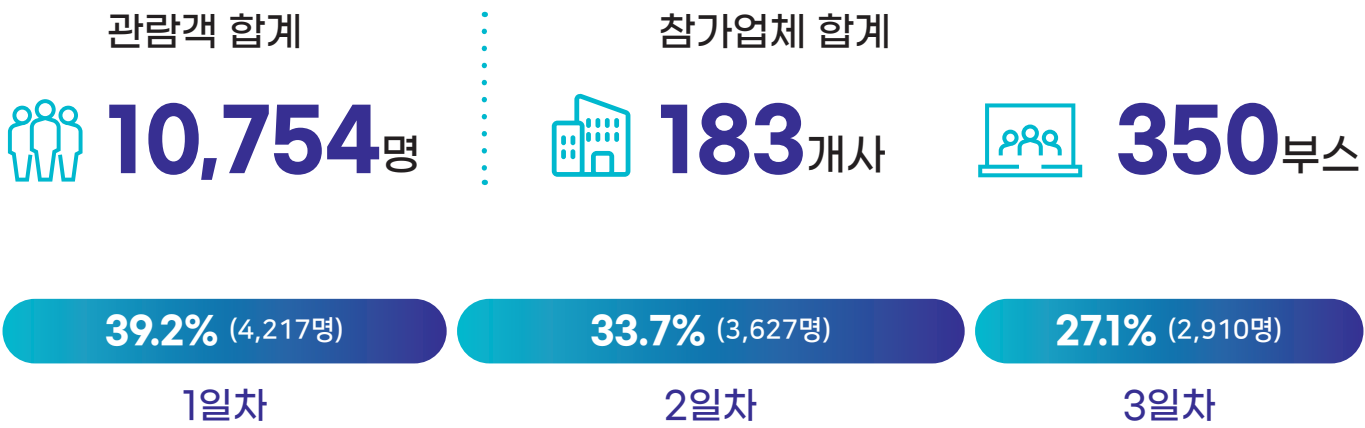


투자사 및 연구기관 (Investors & R&D)

VC/CVC, 학계 및 연구 기관



ASPS 2025 Show Report



Key Visitors

- ALT

· AMKORTECHNOLOGY

· APACT

· ASML

· BOSCH REXROTH

· DB HITEK

· DONGWOO FINE-CHEM

· DOOSAN TESNA

· GS

· HANA MICRON

· HANWHA NXMD

· HYUNDAI MOBIS

· HYUNDAI MOTOR

· INTEL
- ITEK

· JCET STATS CHIPPAC

· LB LUSEM

· LB SEMICON

· LG DISPLAY

· LG ELECTRONICS

· LG INNOTEK

· MCNEX

· NEPES

· NEPES ARK

· NEPES LAWEH

· PARTRON

· QUALCOMM

· RENESAS ELECTRONICS
- SAMSUNG

· SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS

· SAMSUNG SDI

· SAPIEN SEMICONDUCTORS

· SFA SEMICON

· SIEMENS

· SIGNETICS

· SK HYNIX

· SKAICHIPS

· TEKLINE KOREA

· TEXAS INSTRUMENTS

· TOK ADVANCED MATERIALS

· ULVAC

· WINPAC



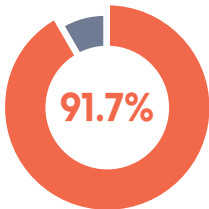
참가업체 피드백



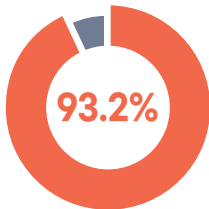
" 해외 바이어와의 미팅 기회가 확대되어 글로벌 네트워크를 넓히는 데 유익했습니다. "

" 잡페어, 세미나, 바이어 투어 등 다양한 프로그램이 함께 운영되어 전시 이상의 성과를 거둘 수 있었습니다. "

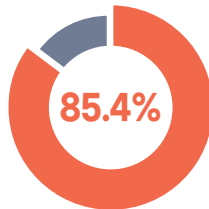
" 사무국의 신속하고 친절한 지원 덕분에 전시 준비와 운영이 원활했으며 쾌적한 환경에서 상담을 진행할 수 있었습니다."



주최자 만족도



관람객 만족도



재참가 의향

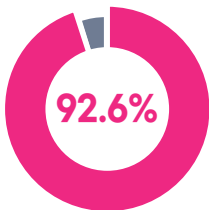
관람객 피드백



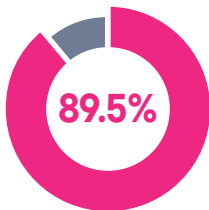
" 주요 패키징 및 소재 관련 기업들을 한 자리에서 만나 산업 동향을 빠르게 파악할 수 있었습니다. "

" 포럼 강연과 전시가 함께 진행되어 전문적인 정보를 습득하면서도 실제 시장 흐름을 확인할 수 있어 좋았습니다. "

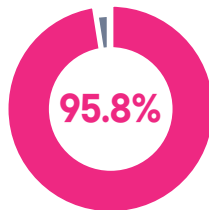
" 현장에서 다양한 업체와 교류하며 향후 협력 가능성을 검토하는 데 큰 도움이 되었습니다. "



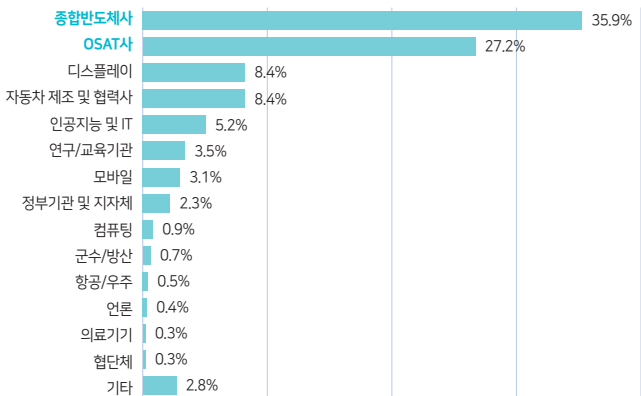
전시회 만족도



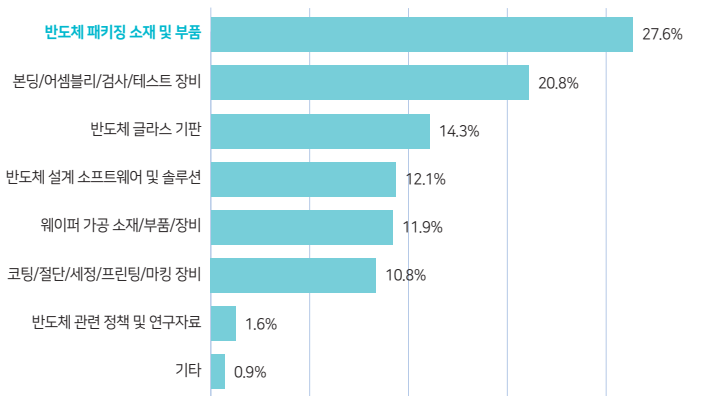
참가업체 만족도



재방문 의향



관람객 업종별 분류



관람객 관심 품목

전시회 참가 신청 절차



부스 타입 및 참가비 안내

<p>독립 부스</p>	<p>기본 부스</p>	<p>프리미엄 부스</p>
<p>2,520,000원 / 부스</p> <ul style="list-style-type: none"> · 전시 면적만 제공 · 공식 시공사 섭외 필수 · 최소 신청 단위 = 2부스 	<p>2,970,000원 / 부스</p> <ul style="list-style-type: none"> · 베이직 조립 타입 부스 · 기본 패키지 포함 · 최소 신청 단위 = 1부스 	<p>4,020,000원 / 부스</p> <ul style="list-style-type: none"> · 프리미엄 블록 타입 부스 · 프리미엄 패키지 포함 · 최소 신청 단위 = 2부스